



Rat der  
Europäischen Union

Brüssel, den 18. Dezember 2019  
(OR. en)

15229/19  
ADD 1

COMPET 803  
MI 851  
ENV 1032  
ENT 270  
TRANS 592  
DELECT 232

### ÜBERMITTLUNGSVERMERK

---

Absender: Herr Jordi AYET PUIGARNAU, Direktor, im Auftrag des Generalsekretärs der Europäischen Kommission

Eingangsdatum: 17. Dezember 2019

Empfänger: Herr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Generalsekretär des Rates der Europäischen Union

---

Nr. Komm.dok.: C(2019) 9121 final

---

Betr.: ANHANG der Delegierten Richtlinie der Kommission zur Änderung des Anhang II der Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Altfahrzeuge hinsichtlich bestimmter Ausnahmen für Blei und Bleiverbindungen in Bauteilen

---

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument C(2019) 9121 final.

---

Anl.: C(2019) 9121 final

Brüssel, den 17.12.2019  
C(2019) 9121 final

ANNEX

**ANHANG**

**der**

**Delegierten Richtlinie der Kommission**

**zur Änderung des Anhang II der Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments  
und des Rates über Altfahrzeuge hinsichtlich bestimmter Ausnahmen für Blei und  
Bleiverbindungen in Bauteilen**

## ANHANG

Anhang II der Richtlinie 2000/53/EG wird wie folgt geändert:

1. Eintrag 8e erhält folgende Fassung:

8e. Blei in hochschmelzenden Loten (d. h. Lötlegierungen auf Bleibasis mit einem Bleianteil von mindestens 85 Gewichtsprozent)	(2)	X
--	-----	---

2. Eintrag 8f Buchstabe b erhält folgende Fassung:

8f. b) Blei in Einpresssteckverbindern (z. B. Compliant-Pin-Technik) außer im Steckbereich der Fahrzeugkabelbaum-Steckverbinder	Vor dem 1. Januar 2024 typgenehmigte Fahrzeuge und Ersatzteile für diese Fahrzeuge	X
---	--	---

3. Eintrag 8g erhält folgende Fassung:

8g. i) Blei in Lötmitteln zum Herstellen einer stabilen elektrischen Verbindung zwischen dem Halbleiterchip und dem Träger in integrierten Flip-Chip-Baugruppen	Vor dem 1. Oktober 2022 typgenehmigte Fahrzeuge und Ersatzteile für diese Fahrzeuge	X
8g. ii) Blei in Lötmitteln zum Herstellen einer stabilen elektrischen Verbindung zwischen dem Halbleiterchip und dem Träger in integrierten Flip-Chip-Baugruppen, wenn diese elektrische Verbindung aus Folgendem besteht:  (i) einem Halbleiter-Technologieknoten von 90 nm oder mehr; (ii) einem einzelnen Chip mit einer Größe von 300 mm <sup>2</sup> oder mehr in jeglichem Halbleiter-Technologieknoten; (iii) gestapelten Chipbaugruppen mit einer Chipgröße von 300 mm <sup>2</sup> oder mehr oder Silizium-Interposern mit einer Größe von 300 mm <sup>2</sup> oder mehr.	(2)  Vor dem 1. Oktober 2022 typgenehmigte Fahrzeuge und Ersatzteile für diese Fahrzeuge	X

4. Folgender Eintrag 8k wird eingefügt:

8k. Löten von Heizanwendungen mit 0,5 A oder mehr Heizstrom je Lötverbindung auf Einfachverbundglas mit einer Stärke von maximal 2,1 mm. Diese Ausnahme gilt nicht für das Löten auf im Zwischenpolymer eingebettete Kontakte.	Vor dem 1. Januar 2024 typgenehmigte Fahrzeuge und Ersatzteile für diese Fahrzeuge	X <sup>(4)</sup>
--	--	------------------

